

SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HIGH FREQUENCY AND OUTPUT

PUB. NO.: 59-031042 [JP 59031042 A]
PUBLISHED: February 18, 1984 (19840218)
INVENTOR(s): KOYAMA MASAHARU
APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)
APPL NO.: 57-141457 [JP 82141457]
FILED: August 12, 1982 (19820812)
INTL CLASS: [3] H01L-023/12; H01L-021/60
JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)
JOURNAL: Section: E, Section No. 248, Vol. 08, No. 119, Pg. 1, June 05, 1984 (19840605)

ABSTRACT

PURPOSE: To eliminate a complicated wire bonding process by a method wherein an insulating patch is placed on the upper side of an insulating substrate while each pad corresponding to each metallic bump and each electrode are connected with one another by means of flip-chip-bonding.
CONSTITUTION: Within a conductor layer 16, the metallic bumps 18a, 18b are respectively bonded on the positions corresponding to a base bonding pad 13 and a base electrode 3 while within another conductor layer 17, the metallic bumps 18c, 18d and 18e are respectively bonded on the positions corresponding to an emitter bonding pad 14 and the both side emitter electrodes 11. An insulating patch 15 is placed on the upper side of an insulating substrate 1 while each pad corresponding to each metallic bump and each electrode are connected with one another by means of flip-chip-bonding.

線(8)径は細くなつていく。また、高出力となるにしたがい、電流容量の増大に応じ金属細線(8)数は幾何級数的に増加し、ワイヤボンディング工程が複雑で面倒になる。また、線数が増加するにしたがい、各金属細線(8)を均一に接続することが、極めて困難になり、このため、高周波特性を悪害することが多くなつていく。

この発明は、絶縁基板上の半導体チップと各電極間との接続を、絶縁基板の下面に形成した接続導体層に固着した複数の金属パンプによる、フリップチップボンディングにより接続し、高周波高出力であつても、従来のような煩雑なワイヤボンディング工程を要せず、接続が簡単になり、各電極までのリードインダクタンスを減少でき、高周波特性が向上される高周波高出力半導体装置を提供することを目的としている。

第2図はこの発明の一実施例による高周波高出力トランジスタの斜視図で、図ではフリップチップボンディングのための絶縁基板は上方に外し下面を手前にして示している。ペリリア磁器など熱

(3)

が設けられた絶縁基板(1)の上方側に当て、各金属パンプにより対応する各パッド部及び各電極とフリップチップボンディングする。こうして、チップ(10)のパッド部(11)とベース電極(3)が電気接続され、パッド部(11)と1対のエミッタ電極(12)が電気接続される。

第2図では簡単のため、パッド部及び各電極をボンディングする各パンプはそれぞれ1個宛としたが、実際には各パンプ複数個宛が配設されていて各並列接続している。

なお、上記絶縁基板(1)に形成した接続導体層(10)を、接続用だけでなく、簡単な整合回路として構成すれば、さらに利得の向上及び広帯域化をも実現することができ、入出力インピーダンスを、高周波における信号源及び負荷インピーダンスである50Ωにまで高めることも可能である。

また、上記実施例では、高周波高出力半導体装置として、高周波高出力トランジスタに適用した場合を示したが、これに限らず他の種の高周波高出力の半導体装置にも適用できるものである。

伝導性の良い絶縁基板(1)の上面にメタライズによるコレクタ電極(2)が設けられ、また、ベース電極(3)及び両側1対のエミッタ電極(12)が形成されている。(11a)はエミッタ電極(12)にそれぞれはんだ固着されたリード、(12)はコレクタ電極(2)上に固着されたトランジスタチップで、上面にベースボンディングパッド部(11)とエミッタボンディングパッド部(14)とが形成されている。

次に(10)はアルミナ、あるいはガラスなど絶縁材からなる絶縁基板で、絶縁基板(1)上のチップ(10)及び各電極部に上方から当てられる。この絶縁基板(10)の下面には、メタライズなどにより接続導体層(10)が形成されている。導体層(10)には、ベースボンディングパッド部(11)に対応する位置に金属パンプ(18a)を、ベース電極(3)に対応する位置に金属パンプ(18b)を固着してある。また、導体層(10)には、エミッタボンディングパッド部(14)に対応する位置に金属パンプ(18c)を、両側の各エミッタ電極(12)に対応する位置に金属パンプ(18d)及び(18e)をそれぞれ固着してある。このように下面に各金属パンプ

(4)

以上のように、この発明によれば、絶縁基板の下面に形成した接続導体層に、半導体チップの各パッド部と各電極とにそれぞれ対応する複数の金属パンプを固着し、この各金属パンプにより、絶縁基板上の半導体チップと各電極とをフリップチップボンディングにより接続したので、高周波高出力であつても、従来のような煩雑なワイヤボンディング工程を要せず、電極までのリードインダクタンスを減少することができ、高周波特性が向上される。また、従来のように高出力に伴う微細化した多数本の金属細線の使用による断線事故がなくなり、信頼性が向上される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の高周波高出力トランジスタの要部を示す斜視図、第2図はこの発明の一実施例による高周波高出力トランジスタの要部を、絶縁基板は外して下面を現して示す斜視図である。

1…絶縁基板、2…コレクタ電極、3…ベース電極、11…エミッタ電極、12…トランジスタチップ、13…ベースボンディングパッド部、14…

